

台灣發明商品促進協會 函

地址：105台北市松山區八德路二段400號7樓

承辦人：賴淑玲

電話：02-8772-3898#19

Email：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：嘉義市立北興國民中學

發文日期：中華民國111年4月9日

發文字號：世發聯字第1110040926號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（1110040926_Attach1.docx、1110040926_Attach2.pdf）

主旨：敬邀 貴校師生參加「2022日本真夏設計創意暨發明展」。

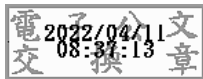
說明：

一、「2022日本真夏設計創意暨發明展」將於111年7月1日~7月3日在東京舉行，這是青年發明家和新銳設計師，促進國際交流與商業合作的最佳平台，敬邀 貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。

二、即日起報名至111年5月31日止，洽詢專線(02)8772-3898分機19賴小姐或email至wiipa168@wiipa.org.tw。

正本：嘉義市立大業國民中學、嘉義市立民生國民中學、嘉義市立北興國民中學、嘉義市立北園國民中學、嘉義市立蘭潭國民中學、嘉義市立玉山國民中學、嘉義市立南興國民中學、嘉義市立嘉義國民中學

副本：



施養隆 會長